

深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-01

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他 (_____)
活动参与人员（排名不分先后）	国海证券、汇添富基金、易方达基金
上市公司接待人员	战略发展部总监、证券事务代表：谢丹；证券事务主管：阳佩琴
时间	2026年1月29日
地点	公司会议室
形式	实地调研
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流主要内容：</p> <p>Q1、请介绍公司2025年业绩预增情况。</p> <p>2025年，公司把握AI算力升级、存储市场需求增长、汽车电动智能化三大增长机遇，通过强化市场开发力度、提升市场竞争力，推动产品结构优化。同时，深入推进数字化转型与智能制造升级，提升运营管理能力，助益公司营收规模和利润实现同比增长。</p> <p>2025年，公司预计实现归母净利润31.5亿元~33.4亿元，预计同比增长68%~78%；预计实现扣非净利润29.9亿元~31.7亿元，预计同比增长72%~82%。（2025年度业绩预告数据仅为公司财务部初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司2025年年度报告中详细披露。）</p> <p>Q2、请介绍公司FC-BGA封装基板产品技术能力及广州封装基板项目爬坡进展。</p> <p>公司已具备20层及以下FC-BGA封装基板产品批量生产能力，22~26层产品的技术研发及打样工作按期推进中。公司广州封装基板项目一期已于2023年第四季度连线，产品线</p>

能力持续提升，产能爬坡稳步推进，已承接 BT 类及部分 FC-BGA 产品的批量订单。2025 年三季度广州广芯亏损环比有所收窄。

Q3、请介绍公司近期产能利用率情况。

公司综合产能利用率仍处于相对高位。2025 年第三季度，PCB 业务总体产能利用率仍处于高位；封装基板业务因存储市场产品需求的增长，工厂产能利用率环比明显提升。2025 年第四季度仍延续上述趋势。

Q4、PCB 工厂产能建设情况。

公司 PCB 业务在深圳、无锡、南通及泰国均设有工厂。一方面，公司通过对现有成熟 PCB 工厂进行技术改造和升级，打开瓶颈，提升产能；另一方面，公司泰国工厂及南通四期项目分别于 2025 年第三、第四季度连线，目前两个工厂均处于产能爬坡早期，前期投入形成的资产或费用已开始折旧、摊销，但因产量有限，单位产品分摊的固定成本较高，对公司利润会造成一定负向影响。

Q5、请介绍公司 PCB 业务在 AI 算力方面的布局情况。

伴随 AI 技术的加速演进和应用上的不断深化，电子产业对于高算力和高速网络的需求日益迫切，驱动了行业对于大尺寸、高层数、高频高速、高阶 HDI、高散热等 PCB 产品需求的提升。2024 年以来，公司 PCB 业务在高速交换机、光模块、AI 加速卡、服务器等领域的 PCB 产品需求均受益于上述趋势。

Q6、请介绍原材料价格变化情况及对公司的影响。

公司主要原材料包括覆铜板、半固化片、铜箔、金盐、油墨等，涉及品类较多。2025年下半年，受大宗商品价格变化影响，金盐、铜等部分原材料价格环比增长。公司将持续关注国际市场大宗商品价格变化以及上游原材料价格传导情况，并与供应商及客户保持积极沟通。

Q7、请介绍无锡新地块规划。

该地块为 PCB 业务算力相关产品的储备用地，预计分期投入，具体投资将根据业务发

	展和市场情况推进实施。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。
附件清单	无